

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

### 关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在马来西亚购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》，公司全资孙公司JSJ MALAYSIA SDN. BHD（以下简称“金三江（马来西亚）”）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际物流园，面积约为73英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。金三江（马来西亚）已与MCKILP Development Sdn Bhd（以下简称“MCKILP”）签订了《关于第1号地块土地的买卖协议》《关于第2号地块土地的买卖协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在马来西亚购买土地事项的提示性公告》（公告编号：2025-044）、《关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告》（公告编号：2025-057）、《关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。

#### 二、交易进展情况

金三江（马来西亚）拟在马中关丹国际物流园投资购买土地共计约73英亩，包括第一号地块土地、第二号地块土地及第三号地块土地。近期，金三江（马来西亚）与MCKILP签订了《关于第3号地块土地的买卖协议》（以下简称“《土地购买协议》”），对应购买土地面积约为24.694英亩，作为公司在马来西亚建设生产基地的经营用地。

#### 三、交易对方基本情况

1、公司名称：MCKILP Development Sdn Bhd

2、注册资本：RM 425, 450, 451. 00

3、董事： LIU JIALIN; EDWARD CHONG SIN KIAT; MA JIANHUA; LING THOU LUNG; LIU BAOHE

4、成立时间：2022-09-07

5、注册地： Suite 15, 6th Floor IOI Business Park Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia.

6、主营业务： NON-RESIDENTIAL BUILDINGS; RESIDENTIAL BUILDINGS, MANAGEMET OF REAL ESTATE ON A FEE OR CONTRACT BASIC.

7、股东结构：由 CHEC Holding (M) Sdn. Bhd. (持有 51%股权) 和 Asas Panorama Sdn. Bhd. (持有 49%股权) 组成的合资公司。

8、公司与 MCKILP 不存在关联关系。

#### **四、交易标的基本情况**

1、地块位置：马来西亚马中关丹国际物流园

2、面积：约 24.694 英亩

3、土地用途/性质：马来西亚建设生产基地的经营用地

#### **五、《土地购买协议》的主要内容**

##### **(一) 协议各方**

1、土地出售方：MCKILP Development Sdn Bhd

2、土地购买方：JSJ MALAYSIA SDN. BHD

##### **(二) 定金及付款约定**

买方同意满足协议先决条件后支付定金给卖方；满足协议对应后续其他先决条件后分期支付购买款给卖方；买方在协议项下的任何购价付款义务存在重大违约，且买方在卖方向其发出书面通知要求其纠正该违约后六十天内未予以补救或纠正或买方违反协议的任何条款，卖方应没收保证金，作为约定的违约赔偿金。

##### **(三) 协议的生效时间**

自协议签署之日起

##### **(四) 交易定价依据**

经交易双方本着公平公正等原则，友好协商一致确定。

#### **六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响**

本次购买土地旨在进一步加强公司马来西亚生产基地建设，资金来源为公司

自有/自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次签署《土地购买协议》后，公司将根据有关规定办理相应权属证书等相关工作，因马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，存在项目实施进度以及投资收益不及预期的风险。后续公司将遵守相关法律法规，积极推进有关事项的落实，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、备查文件

1、JSJ MALAYSIA SDN. BHD 与 MCKILP Development Sdn Bhd 签署的《土地购买协议》。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日